

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. November 2002 (14.11.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/091812 A1

(51) Internationale Patentklassifikation: H05K 13/04

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01523

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: GEBAUER, Uta [DE/DE]; Sebastian-Bauer-Strasse 17, 81737 München (DE); HÖGERL, Jürgen [DE/DE]; Hofweg 28 a, 93053 Regensburg (DE); POHL, Jens [DE/DE]; Sudetenstrasse 5a, 93170 Bernhardswald (DE); WENNEMUTH, Ingo [DE/DE]; Josephsburgstrasse 146 A, 81825 München (DE).

(22) Internationales Anmelde datum:

25. April 2002 (25.04.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; Karl-Theodor-Strasse 69, 80803 München (DE).

(30) Angaben zur Priorität:

101 21 578.9 3. Mai 2001 (03.05.2001) DE

(81) Bestimmungsstaaten *(national)*: JP, KR, US.

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(84) Bestimmungsstaaten *(regional)*: europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

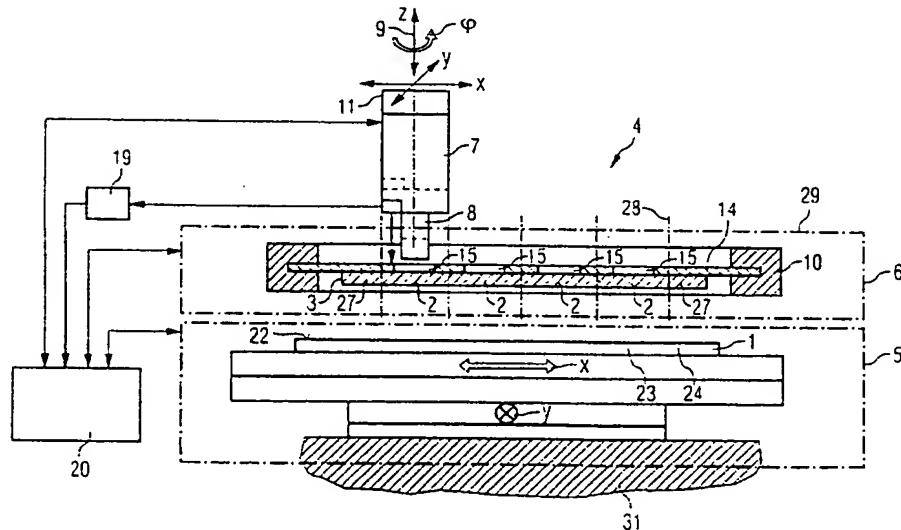
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND COMPONENT SYSTEM FOR PROVIDING A SUBSTRATE WITH ELECTRONIC COMPONENTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND BESTÜCKUNGSSYSTEM ZUM BESTÜCKEN EINES SUBSTRATS MITELEKTRO-NISCHEN BAUTEILEN



WO 02/091812 A1



(57) Abstract: The invention relates to a method and a component system (4) for providing a substrate (1) with an electronic component (2). The component system (4) comprises a substrate carrying device (5) for receiving the substrate, a wafer carrying device (6) placed over the substrate carrying device (5) for receiving a wafer carrying frame (10), as well as a vacuum pincette-holder device (7) placed above the wafer carrying device (6). The wafer carrying frame (10) can receive a complete semiconductor wafer (3) divided into electronic components.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # MAS-FIN-201

Applic. #

Applicant: Jurgen Högerl et al.

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Bestückungssystem (4) zum Bestücken eines Substrats (1) mit einem elektronischen Bauteil (2). Dazu weist das Bestückungssystem (4) eine Substrathalteinrichtung (5) zur Aufnahme des Substrats (1), eine oberhalb der Substrathalteinrichtung (5) Waferhalteinrichtung (6) zur Aufnahme eines Waferhalterahmens (10) und eine oberhalb der Waferhalteinrichtung (6) angeordnete Vakuumpinzetten-Halteinrichtung (7) auf. Dazu kann der Waferhalterrahmen (10) kann einen kompletten in elektronische Bauteile geteilten Halbleiterwafer (3) aufnehmen.